

HBM 需求旺盛推动 Micron 业绩大幅增长

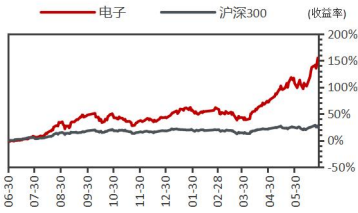
——电子行业周报（20260622-20260628）

行业及产业

电子

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

- 《电子行业周报:SK Hynix 送样 12 层 HBM4E, AI 高端存储迭代提速》2026-06-22
- 《电子行业周报: NVIDIA 携手 SK Hynix 共建 AI 内存与半导体智造新生态》2026-06-15
- 《电子行业专题报告: Vera Rubin 量产提速, RTX Spark 打开终端 AI 新空间》2026-06-08
- 《电子行业周报: 端侧 AI PC 产业化落地, 云端算力需求持续爆发》2026-06-08
- 《电子行业周报: 长鑫科技 IPO 迎来关键节点, Intel 加码玻璃基板与硅光子》2026-06-01

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

- 电子板块行情复盘：**本周 SW 电子指数上涨 5.39%，跑赢沪深 300 指数 (-1.48%)，在 SW 一级行业指数中排名 2/31。AI 算力产业链维持高景气，叠加半导体国产替代政策红利共振，带动板块行情弹性全面释放。各细分板块中，半导体设备 (+16.26%)、半导体材料 (+14.62%)、集成电路封测 (+12.60%) 涨幅居前，品牌消费电子 (-5.64%)、印制电路板 (-4.39%)、光学元件 (-2.54%) 等终端板块走弱。
- 个股方面：**本周 SW 电子个股行情分化显著，有研新材 (+42.93%)、中科飞测 (+40.76%)、珂玛科技 (+37.69%)、聚辰股份 (+36.38%)、富创精密 (+35.17%) 五只半导体相关标的领涨板块；消费电子、印制电路板相关标的回调明显。
- 2026 年 6 月 24 日，Micron 发布 2026 财年第三季度财报。**1) 财报数据显示：本季度公司实现营收 414.6 亿美元 (同比+345.72%，环比+73.75%)；净利润 333.33 亿美元 (同比+1398.11%，环比+106.26%)；毛利率 84.56%，较上季度提升 10.15 个百分点。2) 分业务板块来看：数据中心业务营收维持高速增长，高带宽内存 (HBM) 订单持续饱满，该板块销售额由去年同期 15.3 亿美元大幅攀升至 115 亿美元；除存储芯片外，旗下数据中心固态硬盘营收突破 50 亿美元，云内存业务营收涨幅超 300%、规模达 137.7 亿美元，可全面赋能 AI 算力场景的数据吞吐需求，有效抬升 AI 数据中心整体算力承载上限。3) 公司已搭建成熟 HBM 量产供货体系，同步披露 2026 财年第四财季业绩指引，预计营收区间为 490 亿-510 亿美元。我们认为，Micron 本季度业绩大幅增长，叠加 HBM 长期紧缺行情延续，将持续巩固公司高端存储产品供给壁垒，带动全球 AI 存储产业链景气度持续上行。
- 2026 年 6 月 24 日，Corning 于韩国首尔 POSCO Tower Yeoksam 举办的 AI 数据中心光通信与互连技术大会上，正式发布适配下一代 AI 数据中心架构的玻璃基光互连技术 Glass Bridge。**Glass Bridge 为玻璃材质光连接器，可搭建光子集成电路 (PIC) 与光纤间光路；针对光子芯片光波导、光纤芯尺寸差异问题，公司采用晶圆级离子交换波导工艺在玻璃内部制备埋入式光波导实现光路过渡，省去传统光纤阵列单元，简化组装与精密对准流程。公司同步展出玻璃基板与光互连融合的 CPO 完整架构，依托带穿玻璃通孔 (TGV) 的玻璃载板制备光学波导并倒装集成光子芯片，将玻璃基板由基础封装载板升级为光互连载板，契合先进封装向玻璃基板切换的行业发展趋势。我们认为，Corning 玻璃基光互连与一体化 CPO 方案落地，有望解决 AI 算力高速互联的光路匹配难题，推动玻璃载板、光互连产业链需求持续释放。
- 投资建议：**建议关注国产存储产业链相关投资机会。Micron 2026 财年第三季度营收、利润实现大幅增长，数据中心 HBM 业务营收规模显著扩张，叠加公司成熟 HBM 量产交付能力与大额长期锁单支撑，高端内存供需平衡周期拉长，将持续拉高 HBM 全产业链景气度，AI 高带宽存储增量市场成长空间广阔。
- 风险提示：**1) **海外存储大厂产能投放、产品迭代节奏快于行业预期：**Micron 当前 HBM 订单储备充足、长期供货协议体量较大，若公司加速扩充产能并大幅放开高端 HBM 供给，会加剧全球高带宽内存市场供给竞争，压缩国内存储厂商 HBM 产品价格与盈利空间，延缓国产存储份额提升节奏。2) **国产 HBM 技术研发与量产爬坡进度不及预期：**当前 Micron 等海外厂商已完成多代 HBM 稳定供货并持续推进产品迭代，若国内厂商在多层堆叠 HBM、高速接口、高良率量产等核心技术落地节奏滞后，将持续拉大与海外龙头产品代差，难以充分承接 AI 内存增量市场红利。

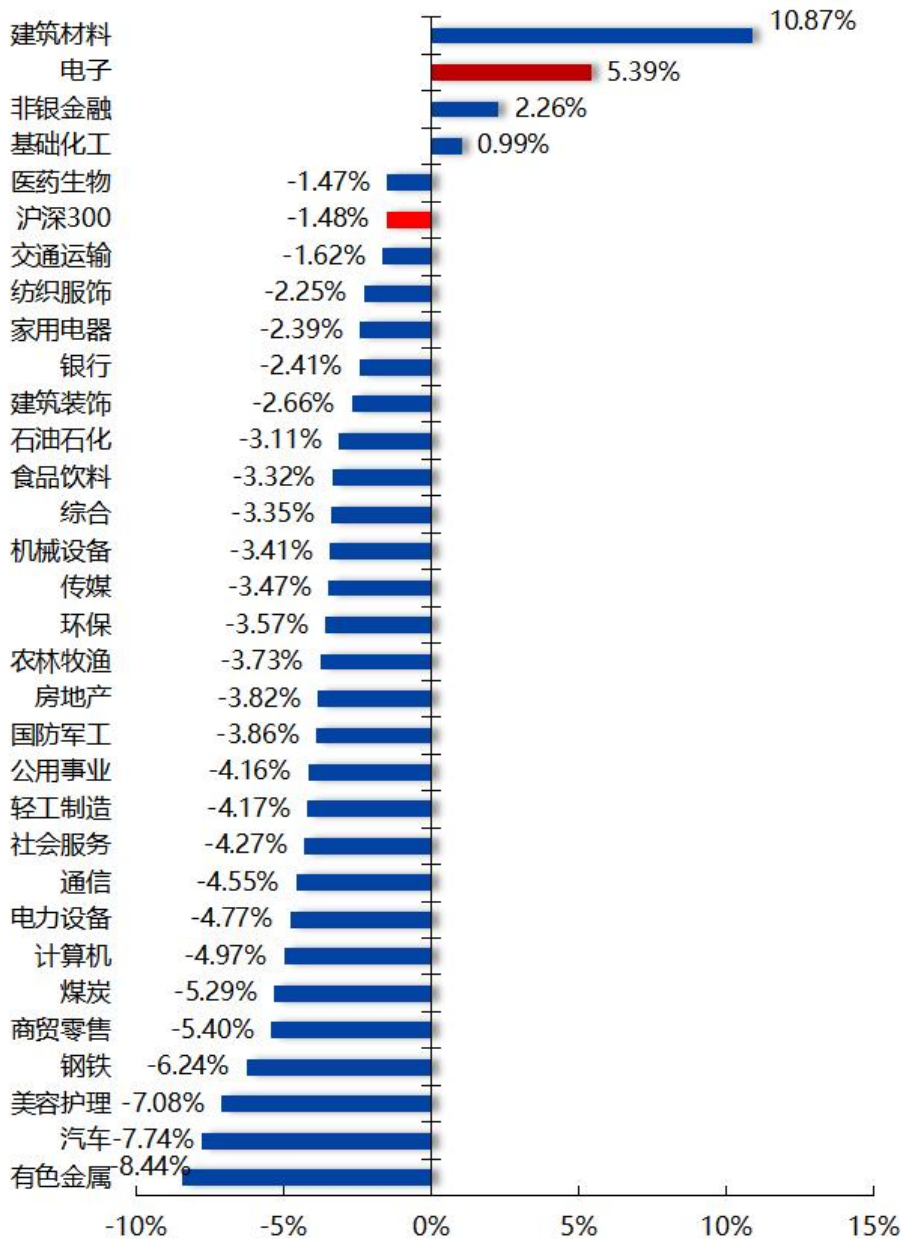
1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子指数上涨 5.39%，跑赢沪深 300 指数 (-1.48%)，在 SW 一级行业指数中排名 2/31。AI 算力产业链维持高景气，叠加半导体国产替代政策红利共振，带动板块行情弹性全面释放。

SW 一级行业涨跌幅排名前五的板块分别为：建筑材料 (+10.87%)、电子 (+5.39%)、非银金融 (+2.26%)、基础化工 (+0.99%)、医药生物 (-1.47%)。排名后五的板块分别为：有色金属 (-8.44%)、汽车 (-7.74%)、美容护理 (-7.08%)、钢铁 (-6.24%)、商贸零售 (-5.40%)。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览

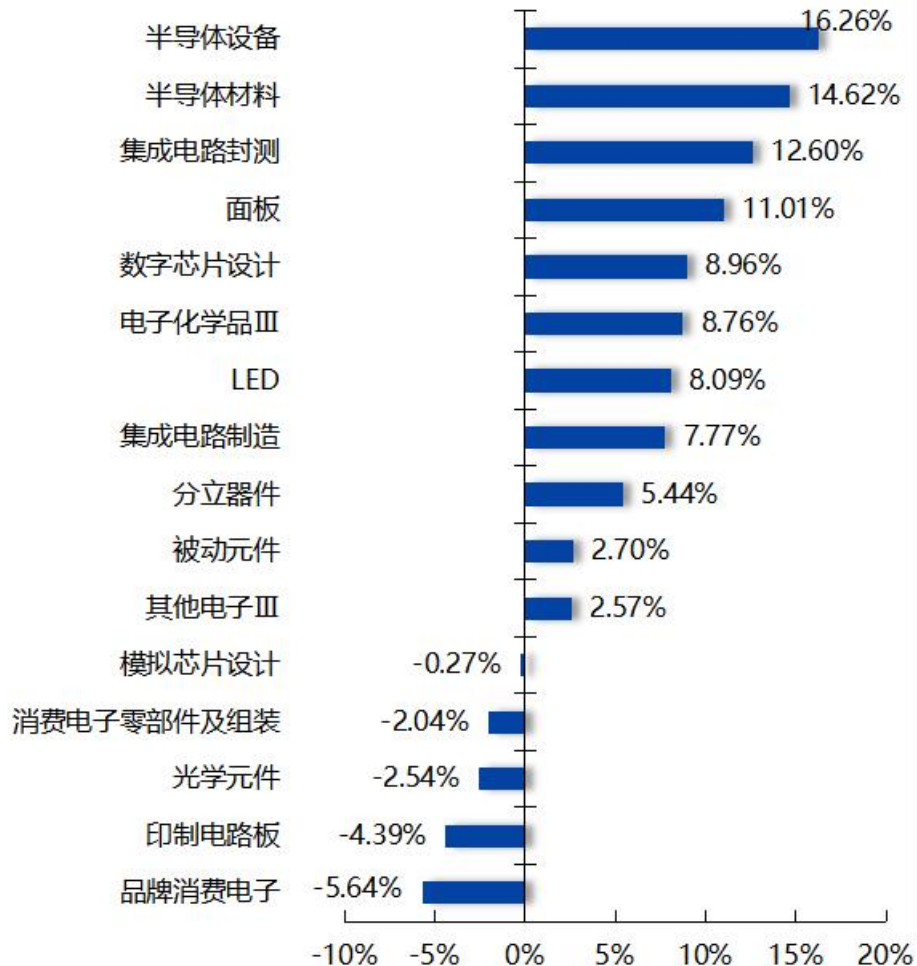


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业分化显著，涨跌幅排名前三的细分赛道分别为半导体设备 (+16.26%)、半导体材料 (+14.62%)、集成电路封测 (+12.60%)；涨跌幅排名后三的细分赛道分别为品牌消费电子 (-5.64%)、印制电路板 (-4.39%)、光学元件 (-2.54%)。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览

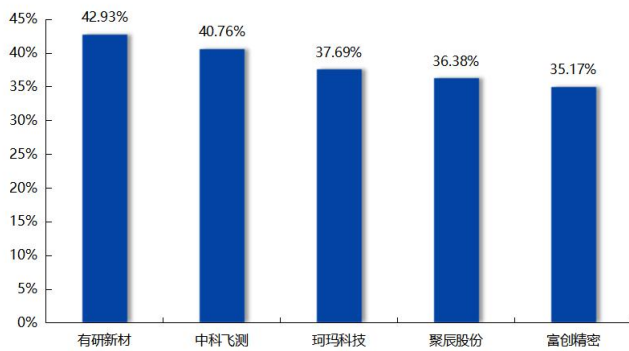


资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

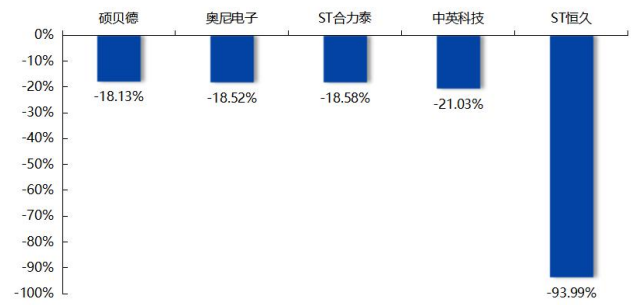
本周 SW 电子个股行情分化显著，有研新材 (+42.93%)、中科飞测 (+40.76%)、珂玛科技 (+37.69%)、聚辰股份 (+36.38%)、富创精密 (+35.17%) 五只半导体相关标的领涨板块；消费电子、印制电路板相关标的回调明显。

图表 3: SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 4: SW 电子个股本周涨跌幅后五



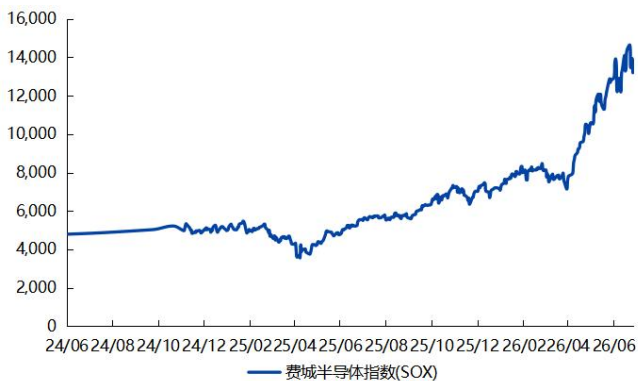
资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

注释: ST 恒久大幅下跌为退市特殊情形, 全文数据均来自 iFinD

1.4 SW 科技行业其他市场表现

费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为-7.94%, 恒生科技指数本周涨跌幅为-7.57%。

图表 5: 本周费城半导体指数涨跌幅为-7.94%



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

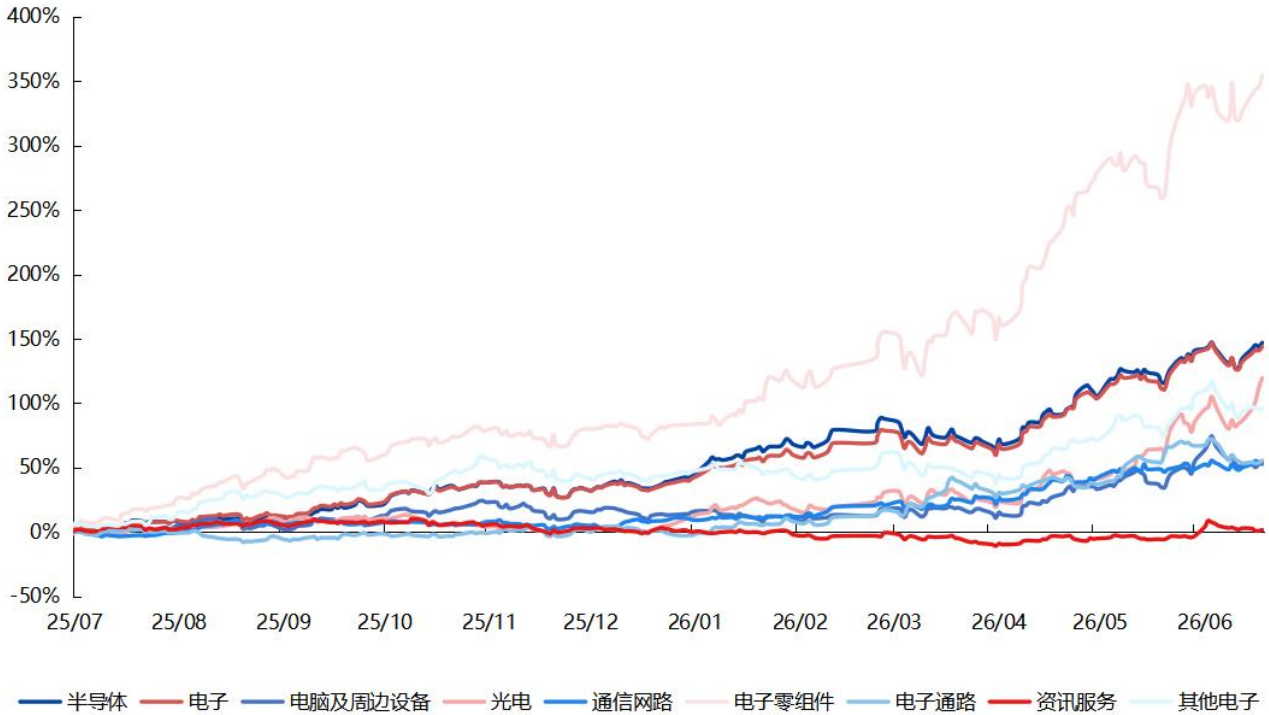
图表 6: 本周恒生科技指数涨跌幅为-7.57%



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

中国台湾电子指数各细分板块本周涨跌幅分别为: 电子通路 (-2.92%)、通信网络 (-3.10%)、半导体 (-3.34%)、电子 (-4.45%)、资讯服务 (-5.36%)、光电 (-5.52%)、其他电子 (-6.72%)、电脑及周边设备 (-7.32%)、电子零组件 (-7.87%)。

图表 7：2025 年 6 月-2026 年 6 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 Micron 发布 2026 财年第三季度财报

新闻：美国时间 2026 年 6 月 24 日，Micron 发布 2026 财年第三季度财报。财报数据显示：本季度公司实现营收 414.6 亿美元（同比+345.72%，环比+73.75%）；净利润 333.33 亿美元（同比+1398.11%，环比+106.26%）；毛利率 84.56%，较上季度提升 10.15%。公司每股摊薄收益 24.67 美元，非通用会计准则下每股收益 25.11 美元。

数据中心业务营收维持高速增长，高带宽内存（HBM）订单持续饱满。该板块销售额由去年同期 15.3 亿美元大幅攀升至 115 亿美元。除存储芯片外，旗下数据中心固态硬盘营收突破 50 亿美元；云内存业务营收大涨超 300%，规模达 137.7 亿美元。

与此同时，Micron 披露下一财季业绩指引，预计 2026 财年第四季度营收区间为 490 亿-510 亿美元。公司管理层表示：受全球 AI 算力基础设施建设持续拉动，叠加原厂产能释放节奏偏谨慎，内存、高带宽芯片供不应求的供需紧平衡格局或将延续至 2027 年以后。

爱建观点：Micron 本季度业绩大幅增长，叠加 HBM 长期紧缺行情延续，将持续巩固公司高端存储产品供给壁垒，带动全球 AI 存储产业链景气度持续上行。

2.2 Corning 推出玻璃基光互连技术 “Glass Bridge”

新闻: 2026 年 6 月 24 日, Corning 在韩国首尔 POSCO Tower Yeoksam 举行的“AI 数据中心光通信与互连技术大会”上, 正式发布了面向下一代 AI 数据中心架构的玻璃基光互连技术“Glass Bridge”。

Glass Bridge 属于玻璃材质光连接器, 可以直接搭建光子集成电路 (PIC) 与光纤之间的光路。光子芯片内部光波导仅数百纳米, 光纤纤芯尺寸达到数微米, 二者存在数十倍的尺寸差距。Corning 采用晶圆级离子交换波导工艺, 在玻璃内部制备埋入式光波导, 完成光路过渡, 省去传统方案里的光纤阵列单元, 大幅简化组装与精密对准工序。

除玻璃桥硬件组件之外, Corning 还对外展示了玻璃基板与光互连融合的 CPO 整体架构。该方案在带有穿玻璃通孔 (TGV) 的玻璃载板上制作光学波导, 再倒装集成光子芯片, 把玻璃基板从单纯的封装基板升级为光互连载板, 匹配先进封装向玻璃基板转型的产业趋势。

爱建观点: Corning 玻璃基光互连与一体化 CPO 方案落地, 有望解决 AI 算力高速互连的光路匹配难题, 推动玻璃载板、光互连产业链需求持续释放。

2.3 长电科技拟 78 亿元在上海临港新建高端先进封测工厂

新闻: 2026 年 6 月 24 日, 长电科技在上交所发布对外投资公告。公告显示, 公司计划出资设立控股子公司, 在上海临港新片区东方芯港万祥工业园建设高端先进封测生产基地。该项目总投资额 78 亿元, 最终投资额以实际建设投入为准; 新设项目公司注册资本拟定为 40 亿元, 剩余资金由项目主体自筹解决。

项目分两期实施: 一期完成洁净厂房土建、室内装修及生产设备采购, 计划 2028 年下半年竣工; 二期聚焦设备添置与产能扩充, 落地节奏将结合一期投产进度、下游订单需求灵活调整。

本次项目用于扩充高端先进封装产能、完善国内产业布局, 公司具备晶圆级、2.5D/3D、系统级、倒装封装全套技术, 产品覆盖 AI 算力芯片、高性能处理器、存储、汽车电子赛道, 将持续巩固行业规模与竞争优势。

爱建观点: 长电科技临港高端封测基地落地将补足国内先进封装产能缺口, 充分承接 AI、车载芯片等高端芯片封测需求, 进一步强化公司在先进封测赛道的地位。

2.4 OpenAI 联合 Broadcom 推出 Jalapeño 芯片

新闻: 美国时间 2026 年 6 月 24 日, OpenAI 与 Broadcom 共同对外发布定制 AI 推理芯片 Jalapeño。

该芯片专为大语言模型推理场景优化, 旨在提升模型运行速度、降低整体算力成本。Broadcom 表示, Jalapeño 芯片落地节奏将快于原有规划, 可将整体算力运行成本

降低 50%。

双方分工清晰，由 OpenAI 负责芯片架构设计，Broadcom 承担硅片研发实现与网络硬件配套，第三方厂商负责板卡与整机系统集成。按照落地规划，该芯片将于 2026 年底实现规模化上机部署，支撑 OpenAI 自有算力集群持续扩容。

爱建观点：OpenAI 联合 Broadcom 自研推理芯片能够大幅压低推理端算力开支，加速大模型商业化落地，同时带动 AI 定制芯片、配套硬件产业链需求上行。

3. 风险提示

1) 海外存储大厂产能投放、产品迭代节奏快于行业预期：Micron 当前 HBM 订单储备充足、长期供货协议体量较大，若公司加速扩充产能并大幅放开高端 HBM 供给，会加剧全球高带宽内存市场供给竞争，压缩国内存储厂商 HBM 产品价格与盈利空间，延缓国产存储份额提升节奏。

2) 国产 HBM 技术研发与量产爬坡进度不及预期：当前 Micron 等海外厂商已完成多代 HBM 稳定供货并持续推进产品迭代，若国内厂商在多层堆叠 HBM、高速接口、高良率量产等核心技术落地节奏滞后，将持续拉大与海外龙头产品代差，难以充分承接 AI 内存增量市场红利。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。